

國碩科技工業 股份有限公司

國碩科技工業股份有限公司

法人說明會
114年11月27日



豁 免 聲 明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

目錄



國碩科技組織



2025年實績

- ☐ 太陽能案場實績
- ☐ 產品別營收毛利
- ☐ 合併損益



2026年展望

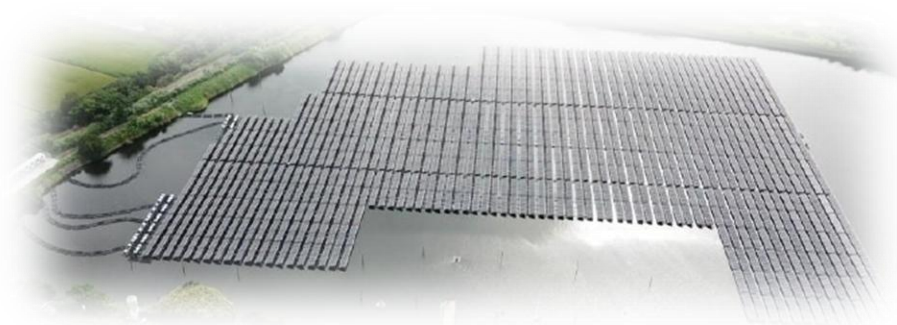


Q&A



國碩科技組織

國碩科技組織



國碩科技

碩禾電子

禾米特材

國碩能源

日發綠能

合資公司

持股比率:
股本(仟元):

36.77%
918,834仟元

90.13 %
103,740仟元

100%
8,000仟元

60%
164,405仟元

禾碩綠電

碩明綠能

聯碩能源

20.34%
2,090,000仟元
➢ 57,453kw案場

17.36%
528,480仟元
➢ 33,936kw案場

49%
336,728仟元
➢ 9,968kw案場

國碩科技2025實績

太陽能案場實績

2025 EPC 實績

- ✓ 合資公司EPC : 15,225KW (已完工5,562KW)
- ✓ 自建電廠: 11,040kw (已開躉) 1,299kw (待掛表)
- ✓ 維運案場: 57,358KW

自持案場

- ✓ 太陽能案場: 12,339KW
- ✓ 儲能案場: 10,600KW+ 6,600KW
- ✓ 綠電轉供: 8,250,000度電/年



彰化1845 KW

合併損益

(新台幣 仟元)

項 目	114前三季	%	113前三季	%
營業收入	4,040,660	100%	5,941,998	100%
營業毛利(損)	365,142	9.0%	398,261	6.7%
營業利益(損失)	(447,721)	-11%	(403,403)	-7%
營業外收入(支出)	(411,301)	-10.2%	76,322	1.3%
稅前淨利(損)	(859,022)	-21%	(327,081)	-5%
稅後淨利(損)	(892,301)	-22.1%	(367,411)	-6.2%
淨(損)利歸屬於母公司	(321,168)	-8%	(102,255)	-2%
非控制權益	(571,133)	-14.1%	(265,156)	-4.5%
基本每股純(損)益	-0.92		-0.29	

國碩科技2026展望

應用-綜合案場規劃

發電

- 自持案場增加
- 案場類型增加

儲能

- 光儲
- 工業用儲能

售電

- 自有案場銷售
- 彈性售電模式

應用

- 綜合場域施作
- 示範場域投入



【國碩科技能源應用整合】

國碩集團旗下合資公司取得南部政府委託興建案，規劃，將舊式平面停車場規劃為「複合式立體停車場」，除了停車位，還納入里民活動中心、日間照顧中心、羽球館、便利商店等多元化機能。停車場將結合太陽能及多項綠能智慧設施，在設計上強調人本的概念，以使用者為導向，預計2026年完工啟用。

- 室內停車場、活動中心等建物頂樓設置太陽光電
- 室外停車場架設太陽能棚架
- 未來規劃中型儲能系統與充電樁使用

應用-能源整合示範場域

發電

- 自持案場增加
- 案場類型增加

儲能

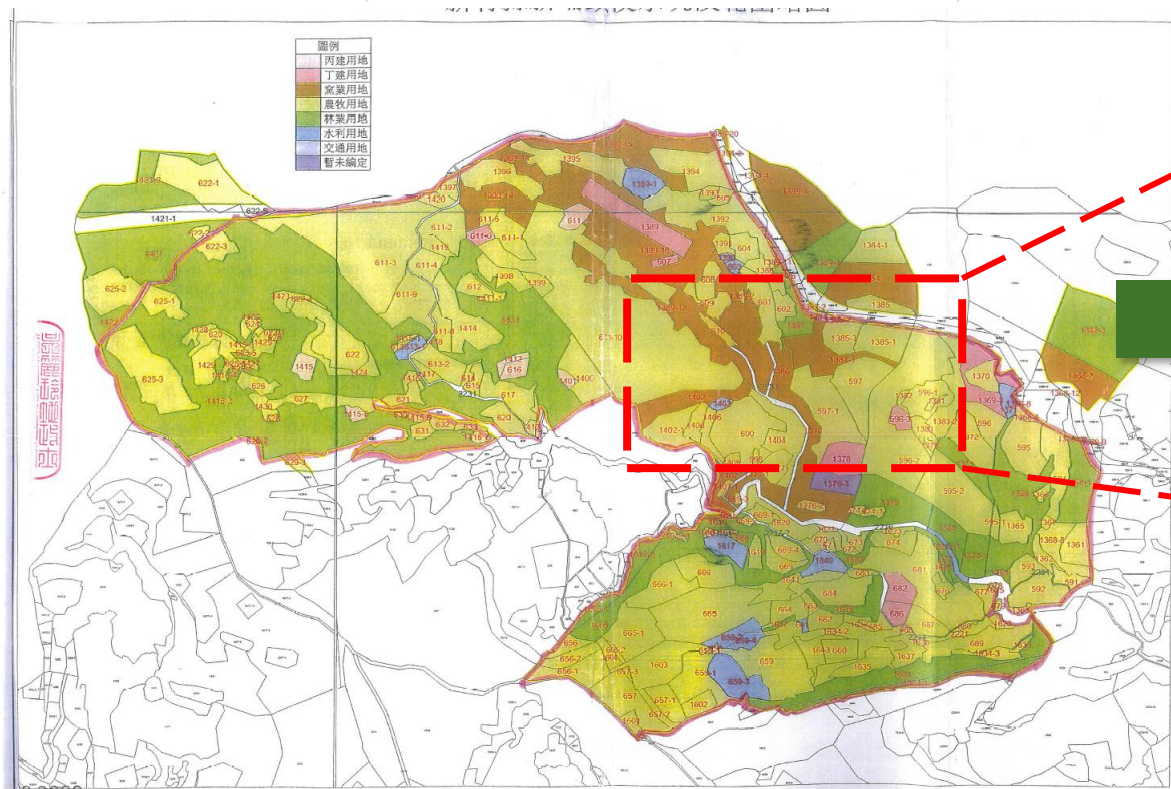
- 光儲
- 工業用儲能

售電

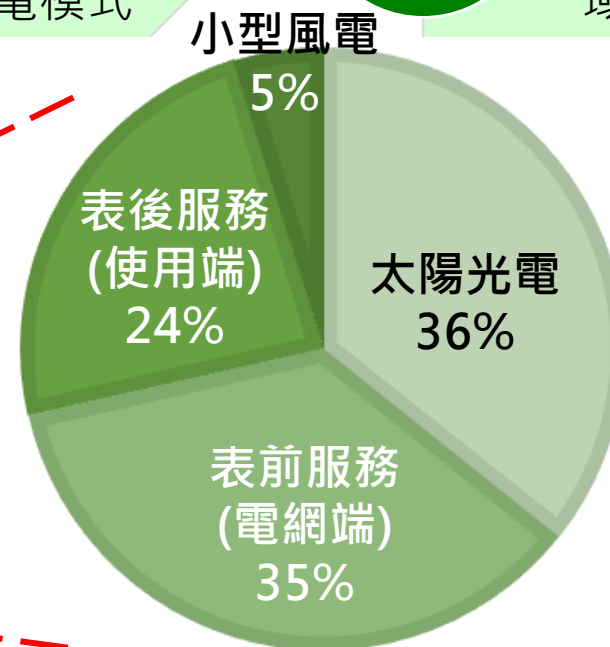
- 自有案場銷售
- 彈性售電模式

應用

- 綜合場域施作
- 示範場域投入



能源規劃



【國碩科技能源整合示範場域-新埔園區】
 規劃新埔園區建設能源示範場域，以兩棟綠色廠辦建築為主體，規劃各項能源使用與整合應用，2025年進行整地工程，預計2026年底進行招商作業。



Di-Fin 直接成型鰭片技術

*for Cold Plate, Vapor Chamber, Boiler/Evaporator,
Immersion System, MCCP/MCLid, MicroFluidics*

GigaStorage

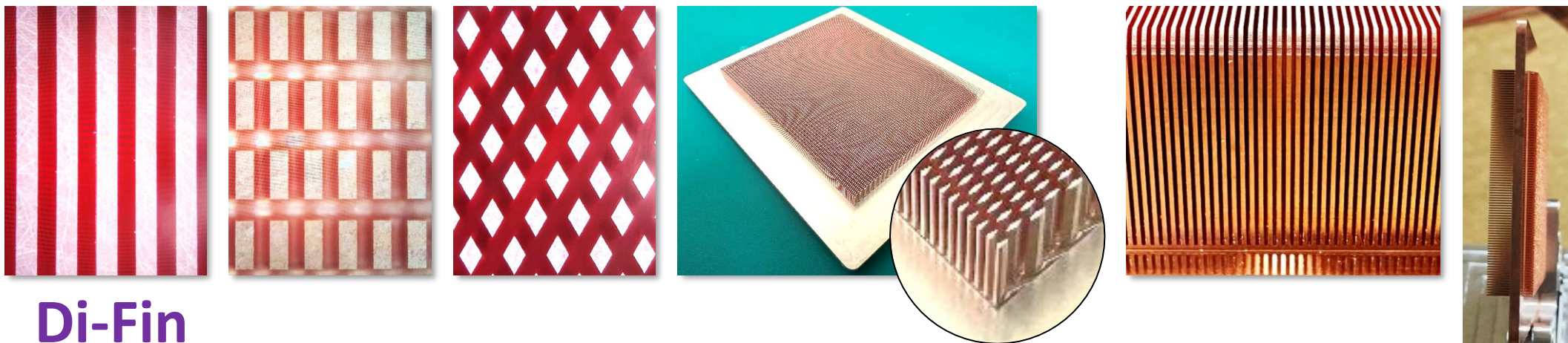
HPC&AI 先進散熱中心

Cran Chu, Ph.D.



Di-Fin 直接成型鰭片技術

- 以**鑽石 (Diamond)** 磨料對材料進行加工。鑽石於高速運動下，能**直接 (Directly)** 在冷板/均溫板等散熱物件表面上，製作出精準**複製 (Duplicated)** 般的鰭片。
- 可一維或二維 (**Dimensions**) 排列，成型出既**深 (Deep)** 且高的鰭片。更甚者，能在物件的正/背面一體成型出**雙面 (Dual-side)** 鰭片，滿足特定之散熱需求。



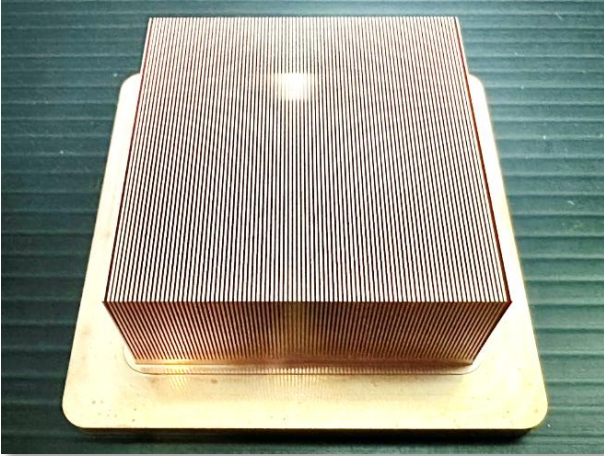
● Di-Fin

➤ **Diamond** ➤ **Direct** ➤ **Duplicate** ➤ **Dimensions** ➤ **Deep** ➤ **Dual**

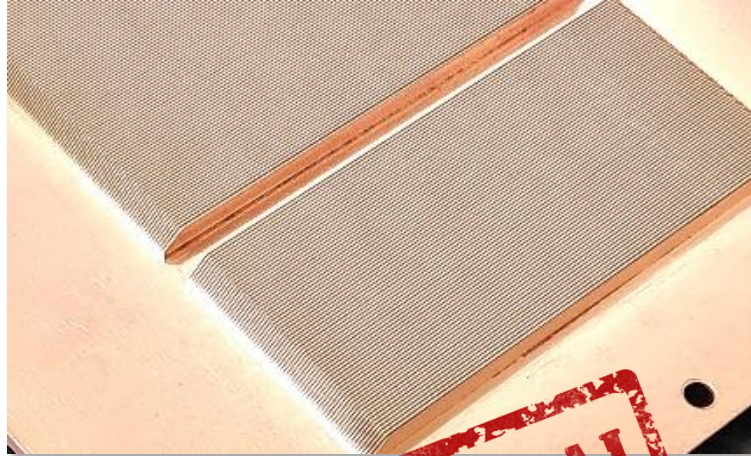


Di-Fin Applications

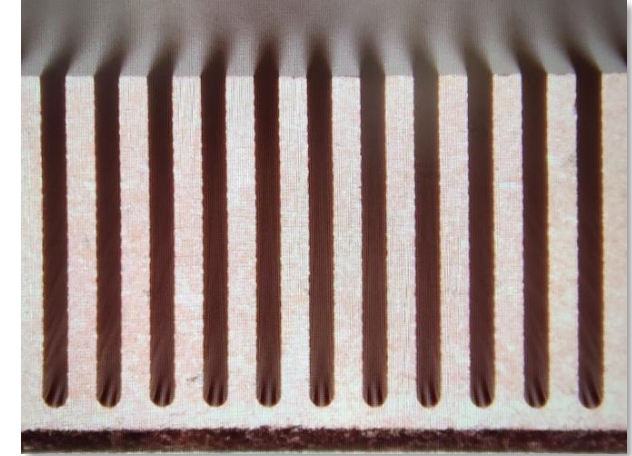
Deep Groove (>10 mm)



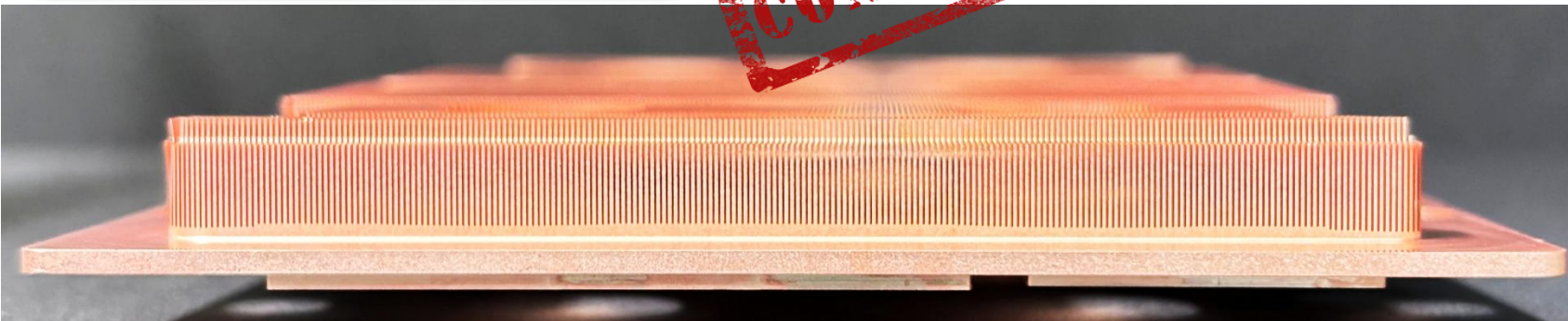
Fin on VC (one piece)



Thin Base (~0.2 mm)



Fin on Module (one piece)

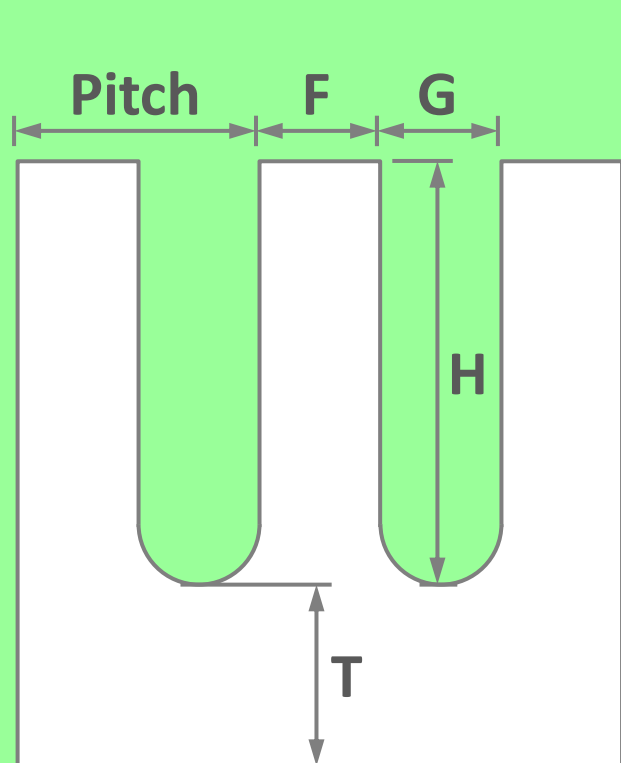


(VC) Boiler

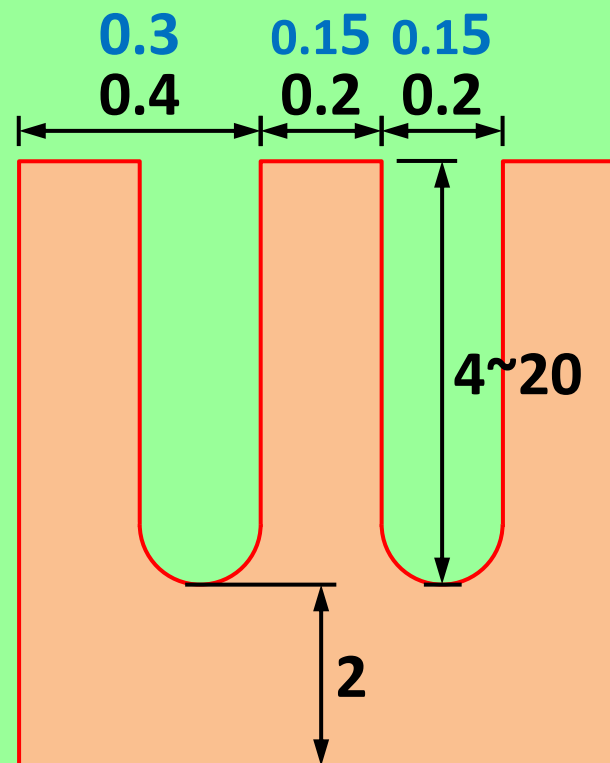


CONFIDENTIAL

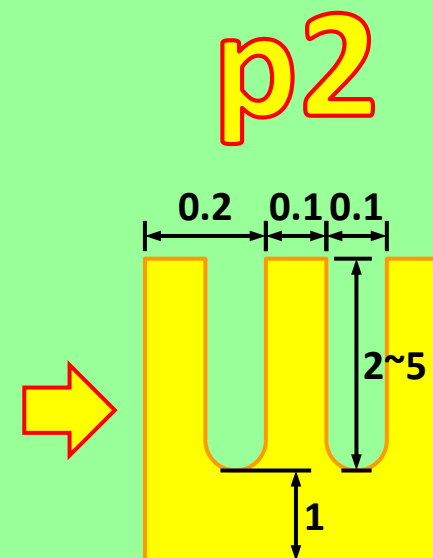
Pitch Evolution: 0.4 → 0.2 → 0.1 (mm)



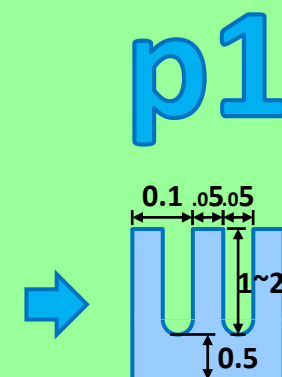
Di-Fin™ Structure



~Present



MCCP/MCL



ultimate

- Single phase system
 - Cold plate (H₂O/PG25)
 - Immersion (Oil)

- Two phase system
 - Cold plate (Refrigerant)
 - Immersion (Dielectric)

Thanks for your attention !

Q&A

國碩科技 | www.gigastorage.com.tw